

TDSによる有機膜の熱処理温度依存性評価

試料のベーク温度の違いによる脱ガスの変化をTDSで確認できます

測定法 : TDS

製品分野 : ディスプレイ・電子部品・照明

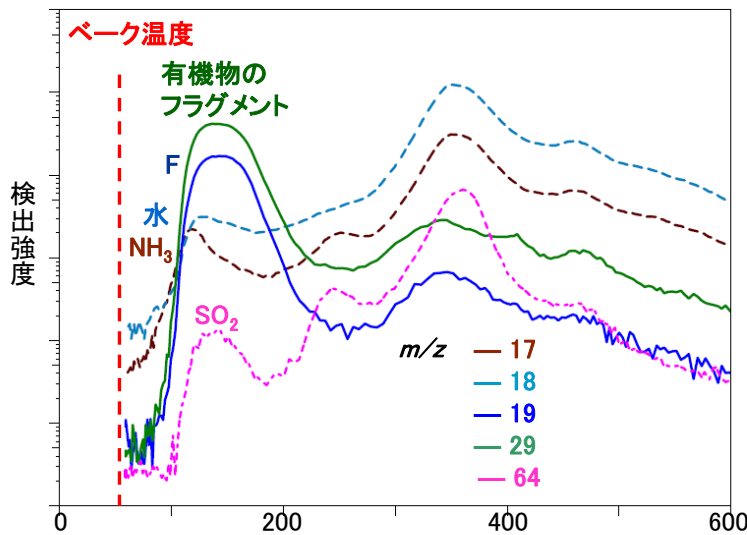
分析目的 : 微量濃度評価・組成評価・同定・昇温による脱ガス分析

概要

TDSは昇温と共に脱離する無機ガス・有機ガスについて、脱離の温度依存性も評価可能です。そのため、試料のベーク温度による脱ガスの評価に有効です。

レジスト膜について50°Cベーク、200°Cベークを行い、それぞれについてTDS分析を行った結果を示します。「50°Cベーク後」に検出された200°Cまでの脱ガスピークが、「200°Cベーク後」では検出されていないことが確認できました。

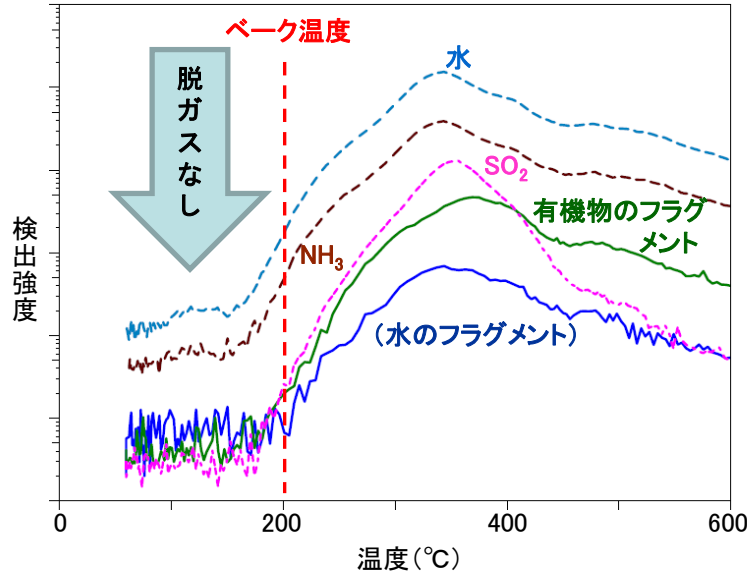
データ



←「50°Cベーク後」

200°Cまでに脱ガスあり

- ・有機物
- ・フッ素
- ・水
- ・アンモニア
- ・SO₂



←「200°Cベーク後」

200°Cまではほぼ脱ガス無し



試料のベーク温度による脱ガスの変化を捉えることができます

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <http://www.mst.or.jp/>